

H6501 _{导电屏蔽胶}

H6501 用于汽车传感器的粘接和 EMI/RF 屏蔽外壳的衬垫。它固化后形成一种柔性的导电粘合剂。 具有增强承载能力和抗冲击能力的特性。

产品描述

产品特性

| 条目 | 描述 | |
|------|------------------------|--|
| 技术类型 | 有机硅 | |
| 组分 | 单组分 | |
| 填料成份 | Ni/C | |
| 固化方式 | 室温湿气固化 | |
| 应用 | 汽车传感器的焊接和电磁干扰、射频屏蔽盒的垫圈 | |

产品优点

- 单组份,室温固化
- 柔软
- 抗冲击

产品性能

| 条目 | 典型值 | 备注 | |
|---------------------------|---------------|-------------------------|--|
| 外观 | 灰黑色膏状 | - | |
| 比重 g/ml | 2.1~2.3 | GB/T 13354 @25℃ | |
| 粘度 mPa·s | 90000 ± 15000 | ASTM D4287,剪切速率 5-S@25℃ | |
| 表干时间 min | <30 | 指触法,25℃/50±5%RH | |
| 25℃/50±5%RH 相对湿度下固化 24 小时 | | | |
| 体积电阻率 Ω·cm | ≤0.04 | 四线法 | |
| 25℃/50±5%RH 相对湿度下固化 72 小时 | | | |
| 硬度 shore A | 62 | GB/T 531.1 | |
| 抗拉强度 N/mm ² | ≥0.8 | GB/T 528 | |
| 断裂延伸率% | ≥80 | GB/T 528 | |
| 25℃/50±5%RH 相对湿度下固化 7 天 | | | |



| 搭接剪切强度 N/mm² | 0.7 | GB/T 7124 |
|--------------|---------|-------------------------------|
| 屏蔽效果 dB | >80 | MIL-DTL-83528C,10MHz to 10GHz |
| 温度使用范围 ℃ | -55~125 | |

使用方法

- 1. 产品在使用前应置于室温下解冻至室温;
- 2. 为获得最佳性能, 粘接表面应清洁并无油脂;
- 3. 产品与空气中的湿气进行反应,因此零件应在点胶后快速进行粘接;

注: 不建议将 H6501 用作就地固化的垫圈(在组装前固化)。

标准包装

- 10g/支
- 按客户需求包装

产品储存

将产品存贮于未开封的原装容器内,并存放在干净、干燥的区域。存储信息同时标注于产品外包装 标签。

本产品最佳存储条件: -20℃, 存储期6个月。

为防止未使用产品受到污染,请不要将任何材料放回原装容器。本公司不对在前述情况以外的条件 下被污染或储存的产品承担责任。更具体的保存期限信息,请咨询 Hanlicon 应用工程师。

注:本文中所含的各种数据仅供参考。对于任何人采用我们无法控制的方法得到的结果,我们恕不负责。自行决定把本产品用在本文中提及的产品应用外,及未采取本文中提及的措施来防止产品在贮存和使用过程中可能发生的损失和人身伤害都是用户自己的责任。本公司明确声明对所有因销售公司产品或特定场合下使用本公司产品而出现的问题,包括针对某一特殊用途的适用性问题,我们不承担责任。公司明确声明对任何必然的或意外损失都不承担责任。建议用户每次在正式使用前都要根据本文提供的数据先做实验。



湖南创瑾科技有限公司

中国湖南省长沙市宁乡经济技术开发区谐园北路 中国长沙智能终端产业园 5 号栋 Tel: +86-731-87827556

www.trumjin.com